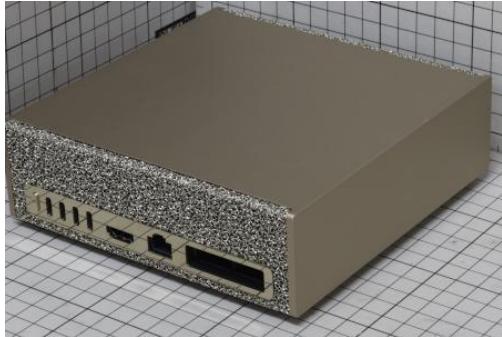
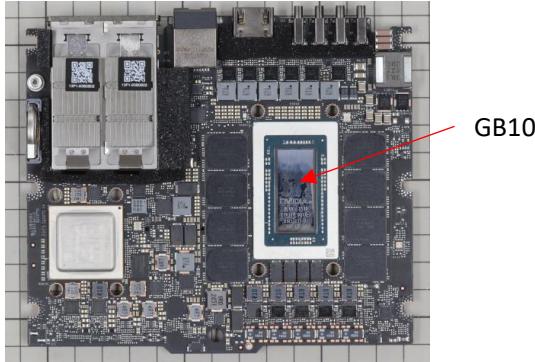


AI Computer : Nvidia GB10 Grace Blackwell_NVIDIA DGX Spark搭載 パッケージ&基板詳細解析レポート



NVIDIA DGX Spark™製品外観



製品基板

製品概要

NVIDIA DGX Spark™は、GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載した世界最小クラスのAIスーパーコンピューターで、卓上サイズながら最大1ペタフロップの性能を発揮し、2000億パラメータ規模の生成AIモデルをローカルで扱える高効率システムです。GB10 Grace Blackwell Superchipは、NVIDIAが2025年に発表した最新AI向けSoCで、CPUとGPUを統合したペタフロップ級の処理性能を持つ革新的チップです。GB10はGrace CPUとBlackwell GPUを2.5D技術で統合し、128GB統合メモリ搭載の高効率小型パッケージです。

今回、以下5つのレポートをリリース予定です。

1. 製品分解、基板搭載半導体部品調査 : 25R-0698-1
2. 基板各層（14層）最細部のL/W測定 : 25R-0698-2
3. パッケージ各層(12層)画像データ : 25R-0698-3
4. 基板、パッケージの断面解析 : 25R-0698-4
5. チップ解析 (Top層、ゲート層、SEM断面 (Seal Ring)) : 25R-0698-5

詳細は次ページへ

解析内容 レポート価格

1. 製品分解、基板搭載半導体部品調査：

価格：680,000円 リリース予定：1/30

- ・ 製品分解過程
- ・ 搭載半導体調査
- ・ データシート（見つかった場合）
- ・ ソケットなどの搭載部品拡大写真

2-1. 基板各層（14層）最細部のL/W測定：

価格：650,000円 リリース予定：3/31

- ・ 各層(14層)の最細部の線幅、線ピッチ測定

2-2. Option : CADデータ

価格：6,000,000円 リリース予定：3/31

- ・ Power,GNDラインの特定
- ・ ODB++、Gerberなど

3-1. パッケージ各層(12層)画像データ：

価格：500,000円 リリース予定：2/27

- ・ 各配線情報（各層(12層)の写真、線幅、線ピッチ）

3-2. Option : CADデータ

価格：2,500,000円 リリース予定：3/31

- ・ Power,GNDラインの特定
- ・ ODB++、Gerberなど

4. 基板、パッケージ断面解析：

価格：250,000円 リリース予定：1/30

- ・ パッケージX線写真
- ・ 断面構造
- ・ 各層厚さ測定

5-1 チップ構造解析：

価格：400,000円 リリース予定：2026/3/31

- ・ Seal Ring部SEM 断面
- ・ Top層、ゲート層写真

5-2 Option: フロアプラン解析

価格：350,000円 リリース予定：2026/4/15

日程、価格は暫定ですので予告なく変更する場合があります。